

■ 半導體工作常用英文單字

No	英文單字	中文解釋
1	Abort	取消
2	Accept	接受
3	Action	行動
4	Add	增加
5	ADI(after develop inspection)	顯影後目檢
6	AE(Assist engineer)	助理工程師
7	Air Shower	空氣潔淨室,用來清除附著在物體上的物質
8	Alarm	警告
9	Alignment	對準；校準
10	AMHS	傳輸系統
11	Anneal	回火
12	APC	先進製程原理:生產過程中用來檢測缺陷
13	Area	區域
14	Arm	手臂
15	ASL(Assistant Shift leader)	副領班:輔助領班
16	Audit	稽核
17	Auto	自動
18	Auto mode	自動模式
19	Auto(on line)	全自動連線
20	Automatic	自動
21	Back Up	備用/支援
22	Backside	背面
23	Bay	走道
24	Bay Rack	貨架:機台旁放置的架子
25	Broken	破片
26	BZ-OFF(Buzz- off)	嗡嗡聲關掉
27	C/T(cycle time)	生產週期
28	Cancel	取消
29	Carrier(FOUP)	盒號
30	Cart	推車:協助搬運之推車
31	CD(critical dimension)	線寬、洞徑
32	Certify (Qualify)	取得資格
33	Chamber	反應室

■ 半導體工作常用英文單字

No	英文單字	中文解釋
34	Change	更換
35	Check	檢查
36	Check sheet	檢查表
37	Chemical Clean	水槽/化學槽:利用濕式蝕刻原理來製造 I.C
38	Child	子(批)
39	Chip	晶粒
40	Chip Yield	晶粒良率
41	Cleaning	清洗
42	Close	關閉
43	CMP	化學研磨 :利用化學研磨原理來製造 I.C
44	Comment	註解
45	Complete	完成
46	Component ID	刻號
47	Confirm	確認
48	Continue	繼續
49	Control	控制
50	Copy	拷貝；複製
51	Count	數；計算
52	Cycle Time	生產週期
53	Daily Check	每日點檢:每 24 小時做一次機台評估
54	DCC	技術資料管理庫
55	Defect	缺陷
56	Deposition	沉積時間
57	DIFF(Diffusion)	擴散
58	Diffusion	擴散
59	Discontinue	中斷；跳離
60	DOWN	當機
61	Downgrade	降級
62	Download	下傳
63	Dummy Wafer	檔片:用來補應擺晶片而未擺的空位置或暖機用
64	E.I	機台使用介面
65	Edit	編輯
66	EE (Equipment Engineer)	設備工程師

■ 半導體工作常用英文單字

No	英文單字	中文解釋
67	Emergent	緊急
68	EMO	緊急停止鍵
69	Empty	空的
70	End	結束
71	Engineer	工程師
72	Enter	輸入
73	Entry	進入
74	Equipment	機台
75	Equipment Information	機台訊息
76	Error	錯誤
77	Etch	蝕刻:利用蝕刻原理來製造 I.C
78	Execute	執行
79	Exit	離開
80	FA(factory automation)	工廠自動化
81	FAB(fabrication)	製造區；生產區
82	Fail	失敗
83	Fast	快速
84	File	檔案
85	Finish	完成
86	Flow	流程
87	Focus	焦距；焦點
88	FUR(furnace)	爐管
89	Gas	氣體
90	Gowning Room	更衣間
91	Group	群體
92	Handle	處理
93	History	歷史資料
94	H-LOT	急貨
95	Hold	扣留
96	Idle	閒置
97	Image	影像
98	Implant	離子植入
99	In spec	合於規格
100	Information	資訊，資料

■ 半導體工作常用英文單字

No	英文單字	中文解釋
101	Input	輸入
102	IUI	智慧型使用者操作介面
103	Job in	登帳
104	Job out	轉帳
105	Key No	批號
106	Layer	層次
107	Left	左邊
108	Lent	借機
109	List	列表；清單
110	Load	載入
111	Load / Unload	導入 / 導出
112	Local Defocus	晶片造成之髒污
113	Location	位置
114	Lock	鎖定
115	Login	註冊:加工啓動
116	Logout	離開:加工完成
117	Lot	批
118	Lot status	貨的狀態
119	M.O(Miss Operation)	作業疏失
120	Machine	機器
121	Maintenance (MAIT)	維修保養
122	Manual	手動
123	Manufacturing	製造
124	Mark	標記；符號
125	Mask (Reticle)	光罩
126	Max	最大值
127	Mean	平均值
128	Measure	量測
129	Menu	目錄
130	Merge	合併
131	Message	訊息
132	Metal	金屬
133	Microwave	微波

■ 半導體工作常用英文單字

No	英文單字	中文解釋
134	Min	最小值
135	Mode	模式
136	Module	模組(部門)
137	Monitor Wafer	測機晶片:每 24 小時測機用晶片
138	Move	移動
139	Next	下一頁
140	Next Step	下一個站點
141	Non-lot	非關產品的批貨
142	Notch	(晶片之)校準缺口
143	Note	註解
144	O.I(operation instruction)	操作指示
145	O.M(operation manual)	操作手冊
146	Off Line	離線式
147	On Line	連線
148	Operation	操作
149	OPI(operator interface)	操作介面
150	Out of spec	超出規格
151	Output	出口
152	Over time	超過時間
153	Owner	擁有者
154	P.M	保養
155	P.R. (Photo Resist)	光阻
156	Paper run card	流程卡
157	Particle	微塵粒子
158	Particle Wafer	測微塵量用晶片
159	Password	密碼
160	Pattern	圖案樣式
161	Pause	暫停
162	PE(process engineer)	製程工程師
163	Peeling	剝落
164	Photo	顯影(黃光):利用顯影原理來製造 I.C
165	PM(preventive maintenance)	機台保養
166	PMSFAB3	生產管理系統

■ 半導體工作常用英文單字

No	英文單字	中文解釋
167	PNDN	異常處理單
168	Previous Step	上一個站點
169	Priority	優先順序(等級)
170	Process	製程；進行
171	Process code	工程碼
172	Product	產品
173	Production	生產部
174	Production Wafer	產品:製造 I.C 的晶片
175	Program	程式
176	Pump	幫浦
177	Q-Time	留置時間
178	Qualify	取得資格
179	Quality	品質
180	Quantity (QTY)	數量
181	Question	問題
182	Quit	離開
183	Range	範圍
184	Ready	預備
185	Recipe	程式
186	Recipe(PPID)	程式:當晶圓/片進入機台加工時所提供的一定步驟
187	Record	記錄
188	Recycle	回收
189	Reject	退回 (出)
190	Release	放行:產品異常時,由製程判斷之
191	Reserve	預約
192	Reset	重設
193	Resist	光阻
194	Restart	重新開始
195	Retry	再試
196	Rework	重作:機台當機時產品未 run 或跑到一步驟時,由製程判斷之
197	Right	右邊
198	RTD	自動排貨系統
199	Run	跑 (生產)

■ 半導體工作常用英文單字

No	英文單字	中文解釋
200	Run Card	註明程式內容的卡片
201	Safety	安全
202	Sample	樣本
203	Save	儲存
204	Scan	掃描
205	Schedule Team	特殊產品追蹤
206	Scrap	報廢
207	Scratch	刮傷
208	Scrubber	清潔
209	Select	選擇
210	Setup	設定
211	SL(Shift leader)	領班:生產人員管理
212	SOP	標準作業程序
213	Sorter	晶片分片/整理機:用來做晶片的刻號檢驗或是分批整理用
214	Spec	規格:產品加工後,確認加工是否在規範內
215	Specification (Spec)	規格
216	Split	分批
217	Stage	平台
218	Stand by	等待,待命
219	Start	開始
220	State	狀態
221	Status	狀況
222	Step	步驟
223	Stocker	倉儲
224	Stop	停止
225	Supervisor	組長:部門生產管理者
226	Supply	供給
227	Surface	表面
228	System	系統
229	T/F CMP	化學機械研磨
230	T/F(thin film)	薄膜
231	TA(Technician Assistant)	助理技術員
232	Target	目標

■ 半導體工作常用英文單字

No	英文單字	中文解釋
233	TE(technician)	技術員
234	Temp(Temperature)	溫度
235	Test	測試；試驗
236	Test run	驗機:測試機台的膜厚及微塵量以反應機台的穩定度
237	Test Wafer	驗機晶片:驗機時使用的晶片
238	Thickness	厚度
239	Thin Film	薄膜:利用薄膜原理來製造 I.C
240	Time	時間
241	Transportation	搬送,運送
242	Trouble	問題；錯誤
243	Type	形式
244	Uniformity	均勻度
245	Unload	載出
246	Update	更新資料
247	Vender	廠商:機台製程/設備工程師
248	Wafer	晶片:晶塊加入矽後拉成柱狀再經切割成片狀
249	Wait	等待
250	Wet Etching	濕蝕刻
251	WIP(Work in progress)	待加工與正在加工的產品
252	WRC	晶片回收/清洗:生產過程使用晶片回收清洗區
253	Wrong	錯誤
254	WT(wafer testing)	晶片測試區
255	Yield	良率
256	Monday	星期一
257	Tuesday	星期二
258	Wednesday	星期三
259	Thursday	星期四
260	Friday	星期五
261	Saturday	星期六
262	Sunday	星期日
263	January	1 月
264	February	2 月



265	March	3 月
266	April	4 月
267	May	5 月
268	June	6 月
269	July	7 月
270	August	8 月
271	September	9 月
272	October	10 月
273	November	11 月
274	December	12 月